

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和7年6月18日(2025.6.18)

【国際公開番号】WO2024/075343

【出願番号】特願2024-555625(P2024-555625)

【国際特許分類】

C 0 8 L 63/00(2006.01)

C 0 8 K 5/34(2006.01)

C 0 8 K 9/06(2006.01)

H 0 1 L 23/29(2006.01)

C 0 8 G 59/22(2006.01)

10

【F I】

C 0 8 L 63/00 C

C 0 8 K 5/34

C 0 8 K 9/06

H 0 1 L 23/30 R

C 0 8 G 59/22

【手続補正書】

20

【提出日】令和6年10月10日(2024.10.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリテトラメチレングリコール型エポキシ樹脂と、
窒素原子を含有する複素環化合物と、
フィラーと、を含有し、
前記フィラーが、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、及びN-フェニル
-3-アミノプロピルトリメトキシシランの少なくともいずれかにより表面処理され、
前記フィラーの含有量が、エポキシ樹脂組成物の全量に対して、55質量%以上77質
量%未満である、
エポキシ樹脂組成物。

30

【請求項2】

前記フィラーの平均粒径が、2.0 μm以下である、
請求項1に記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項3】

前記フィラーのトップカット径が、15 μm以下である、
請求項1又は2に記載のエポキシ樹脂組成物。

40

【請求項4】

全塩素量が、エポキシ樹脂組成物の全量に対して、1,300 ppm以下である、
請求項1又は2に記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項5】

250 μm以下の間隙にアンダーフィル材として注入される、
請求項1又は2に記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項6】

請求項1又は2に記載のエポキシ樹脂組成物により封止されている、

50

半導体装置。

【請求項7】

支持体と、前記支持体上に配置されている半導体素子との間隙に、請求項1又は2に記載のエポキシ樹脂組成物を充填する工程と、

前記エポキシ樹脂組成物を硬化させる工程と、を有する、半導体装置の製造方法。

10

20

30

40

50